

「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発（委託）」

実施予定先一覧

No.	開発テーマ	実施予定先
1	(d) 国際連携による次世代半導体製造技術開発(委託) (d5) 先端パッケージング等を含む後工程高度化プラットフォームの構築 (d5-1)先端パッケージング等を含む後工程の自動化にかかる技術開発	半導体後工程自動化・標準化技術研究組合

以上